

114學年度教師產業研習 半導體封裝測試與 設備實務應用培訓營

課程簡介

本課程由專家學者與業師共同授課，課授封裝與測試的專業知識及先進封裝所衍生的技術挑戰。在實務應用先規劃學員如何操作晶圓切割機、固晶機、打線機及QFN自動化封裝設備。爾後再訓練學員如何設置功率IC測試系統、檢修電路、測試程式開發及使用晶圓針測機，讓學員充分了解IC元件封裝到測試等一系列核心專業職能與實務應用。

課程時間 / 地點

第一梯次

115/01/19(一)至115/01/30(五)

每週一至五早上8:30至下午16:30

第二梯次

115/07/13(一)至115/07/24(五)

每週一至五早上8:30至下午16:30

電子工程系館-210教室

明新科技大學半導體人才培育基地

合作廠商

- 明志科技大學
教師產業研習研究專案辦公室
- 工研院電子與光電系統所
異質整合智能系統組
- 力成科技股份有限公司
- 廣化科技股份有限公司
- 美達科技股份有限公司

參與對象/報名資訊

高中職及大專院校教師

報名時間：即日起至115年1月14日

報名網址如下：免費·名額30人

<https://forms.gle/jQtvY4DZymReEbBh9>



聯絡人

明新科技大學半導體學院

半導體人才培育基地辦公室

郭人榮助理

TEL : 03-5593142 #3270、3162